

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
活动参与人员（排名不分先后）	上海十溢投资、国盛证券、光大证券、万联证券、瑞银证券、中国银河证券、Morgan Stanley、中泰证券、瑞士银行（香港）、Point72 HongKong Limited、东亚前海证券、美林（亚太）、汇丰前海证券、上海申银万国证券研究所、长城财富保险资管、华泰证券、华安财保资管、东方财富证券、摩根证券投资信托、百年保险资管、海富通基金、民生证券、上海世亨私募基金、华能贵诚信托、兴业证券、野村国际（香港）、润晖投资、香港瑞银集团、中信证券、财通证券、大家资产管理、易唯思、海通证券、国华兴益保险资管、华源证券、广发证券、中银国际证券、申万宏源证券、招商证券、摩根士丹利基金、国金证券、前海再保险、建银国际证券、第一上海证券、瑞士银行（中国）、华发证券、开源证券、渤海证券、盛钧私募基金(湖北)、合众资管、花旗环球金融亚洲、方瀛研究与投资（香港）、统一证券投资信托、英大保险资管、西南证券、西部证券、深圳市兴亿投资、南京证券、国信证券、北京鼎天投资、中航证券、国泰海通证券、鲍尔赛嘉(上海)投资管理、深圳昭图投资、海筌笠资管、财通基金、德邦基金、上海晟盟资管、上海石锋资管、上海钦沐资管、农银汇理基金、上海明河投资、中国国际金融、国联安基金、深圳市凯丰投资、上海毅木资管、鹏扬基金、广东九易资本、华创证券、上海博笃投资管理、兴业基金、国寿安保基金、上海东方证券资产、誉辉资本管理（北京）、珠海横琴长乐汇资本、北京泽铭投资、长盛基金、北京衍航投资管理、国投瑞银基金、摩根基金、上海摩旗投资、创金合信基金、玄元私募基金投资管理(广东)、上海证券、上海敦颐资管、上海景领投资管理、长城基金、平安基金、银华基金、富安达基金、上海亘曦私募基金、华泰保兴基金、圆信永丰基金、嘉实基金、上海聆泽私募基金、国海证券、华方私募基金、太平基金、中海基金、诺德基金、上海宽远资管、汇添富基金、上海益昶资管、易方达基金、上海高毅资管、东吴基金、中信建投证券

上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2026年3月12日
地点	电话及网络会议
形式	电话及网络会议
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 2025 年年度经营业绩情况。</p> <p>2025 年，公司把握 AI 算力升级、存储市场需求增长、汽车电动智能化三大增长机遇，通过强化市场开发力度、提升市场竞争力，推动产品结构优化。同时，深入推进数字化转型与智能制造升级，提升运营管理能力，实现营收和利润同比增长。</p> <p>报告期内，公司实现营业总收入 236.47 亿元，同比增长 32.05%；归属于上市公司股东的净利润 32.76 亿元，同比增长 74.47%。其中，PCB 业务实现主营业务收入 143.59 亿元，同比增长 36.84%，占公司营业总收入的 60.73%；毛利率 35.53%，同比增加 3.91 个百分点。封装基板业务实现主营业务收入 41.48 亿元，同比增长 30.80%，占公司营业总收入的 17.54%；毛利率 22.58%，同比增加 4.43 个百分点。电子装联业务实现主营业务收入 30.75 亿元，同比增长 8.93%，占公司营业总收入的 13.00%；毛利率 15.00%，同比增加 0.60 个百分点。</p> <p>Q2、请介绍 2025 年公司 PCB 业务营业收入及毛利率变动原因。</p> <p>2025 年，公司 PCB 业务实现主营业务收入 143.59 亿元，同比增长 36.84%，占公司营业总收入的 60.73%；毛利率 35.53%，同比增加 3.91 个百分点。</p> <p>2025 年 PCB 业务受益于数据中心领域 AI 服务器及相关配套产品需求加速释放，订单同比显著增加；高速交换机、光模块需求显著增长，有线通信相关产品占比持续提升；把握 ADAS 和新能源汽车三电系统的增长机会，汽车电子领域收入快速增长。在上述因素的作用下，公司营收规模增加、产能利用率提升、产品结构优化，带动 PCB 业务毛利率上行。</p> <p>Q3、请介绍 2025 年公司封装基板业务营业收入及毛利率变动原因。</p> <p>2025 年，公司封装基板业务实现主营业务收入 41.48 亿元，同比增长 30.80%，占公司营业总收入的 17.54%；毛利率 22.58%，同比增加 4.43 个百分点。封装基板技术能力快速突破，产品与客户导入进程加速，订单同比快速增长。受益于存储类、处理器芯片类基板需求</p>

拉动，产能利用率提升，存储类基板占比增加，叠加广州工厂爬坡顺利，助益封装基板毛利率改善。

Q4、请介绍 2025 年公司电子装联业务在下游市场拓展情况。

公司电子装联业务实现主营业务收入 30.75 亿元，同比增长 8.93%，占公司营业总收入的 13.00%；毛利率 15.00%，同比增加 0.60 个百分点。

公司电子装联产品按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗电子、汽车电子等领域。2025 年，公司电子装联业务充分把握数据中心及汽车电子领域需求的增长机会，深化客户战略协同，积极推进客户关键项目，强化专业产品线竞争力建设，带动相关业务营收稳步增长。

Q5、请介绍公司近期产能利用率情况。

公司 PCB 业务受益于 AI 算力基础设施硬件相关产品需求的增长，工厂产能利用率维持高位；封装基板业务因存储类、处理器芯片类基板需求拉动，工厂产能利用率延续 2025 年四季度以来的较高水平。

Q6、请介绍 PCB 工厂产能建设情况。

公司 PCB 业务在深圳、无锡、南通及泰国均布局生产基地，其中泰国工厂与南通四期项目已于 2025 年下半年顺利连线投产，目前产能正稳步爬坡。此外，公司也在持续开展技改，并将根据市场情况，适时推进新项目论证和建设。

Q7、请介绍公司广州封装基板项目爬坡进展。

2025 年以来，公司广州封装基板项目产品线能力持续提升，其中 BT 类封装基板产能爬坡稳步推进，FC-BGA 类封装基板已实现 22 层及以下产品量产，24 层及以上产品技术研发及打样工作按期推进。2025 年广州广芯亏损同比缩窄。

Q8、请介绍公司 2025 年度研发投入情况。

2025 年公司研发投入金额 15.91 亿元，占公司营收比重为 6.73%。公司各项研发项目进展顺利，下一代通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，FC-BGA 基板产品能力建

	<p>设，FC-CSP 精细线路基板和存储基板技术能力提升等项目均按期稳步推进。</p> <p>Q9、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。</p> <p>公司主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多。2025 年，受大宗商品价格变化影响，铜箔、金盐等关键原材料价格同步上行，对公司盈利水平构成一定影响。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>